

6216底部填充胶价格【CSP芯片底部填充剂】

产品名称	6216底部填充胶价格【CSP芯片底部填充剂】
公司名称	山东凯恩新材料科技有限公司
价格	2000.00/kg
规格参数	品牌:KY 型号:6216 产地:山东
公司地址	福山区进和路60号
联系电话	0535 - 6932581 18596196886

产品详情

【底部填充胶介绍】

底部填充胶（underfill），是一种高流动性，高纯度的单组份环氧树脂灌封材料。能够通过创新型毛细作用在CSP和BGA芯片的底部进行填充，经加热固化后形成牢固的填充层，降低芯片与基板之间因热膨胀系数差异所造成的应力冲击，提高元器件结构强度和可靠性。

品牌：KY

生产厂家：山东凯恩新材料

固化方式：加热固化

常规包装：30ml/支，1000ml瓶装

价格：底部填充胶厂家直销，价格更合理，性价比高。

【KY底部填充胶型号】

6200底部填充胶，粘度375 mpa·s，推荐固化条件8min/130℃；

6213底部填充胶，粘度300-6000 mpa · s，推荐固化条件15min/150 ；

6216底部填充胶，粘度3000 mpa · s，推荐固化条件15min/120 ；

6217底部填充胶，粘度2000-4500 mpa · s，推荐固化条件10min/100 ；

6249底部填充胶，粘度2350 mpa · s，推荐固化条件5min/120 。

了解详细的underfill底部填充胶密度、适用期、热膨胀系数等参数，以及了解底部填充胶品牌、价格、应用等，可进入了解：

<http://www.kychemical.com/product-list-2-4-1.html>

【6216底部填充胶优点】

- 1、可返修环氧树脂底部填充剂，可与大多数无铅和无卤焊膏兼容；
- 2、KY产品能够形成均匀且无空洞的底部填充层，固化后为焊点提供优良的机械保护；
- 3、可以对极细间距的部件进行快速填充，具有快速固化能力。

【6216底部填充胶典型应用】

6216底部填充胶主要用于CSP和BGA芯片的底部进行填充。

【关于凯恩】

山东凯恩，是一家汇聚了海内外多位应用化学领域的科学家、商业精英和专业团队的高科技产业公司，致力于高分子材料、胶黏剂、精细化工等应用化学领域的高新技术研究和高端产品的开发与制造。在深圳设有商务及技术服务中心（下辖专业的检测实验室）；在苏州、长春设立有销售和服务机构，就近服务通讯、电子、玩具、汽车行业等诸多重要客户。

联系人：张经理 电话：0535-6932581 手机：18596196886 Q Q：2632520435

邮箱：cs@kychemical.com